

# 智慧電子人才應用發展推動計畫 110 年度短期在職訓練班入選班級

## ◎正取班級

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 <sup>1</sup> (元)
1	三建資訊有限公司	【日本專家】FOWLP/PLP 先進 3D 封裝整合	168,000
2	三建資訊有限公司	【日本專家】5G 高階化及 6G 所需的高分子材料技術動向・與材料設計實用化	120,000
3	三建資訊有限公司	【日本專家】塗佈生產技術訣竅與各種塗佈不均勻橫紋的原因與對策	120,000
4	三建資訊有限公司	【日本專家】環氧樹脂硬化劑的選擇方法與半導體封裝材料的最新技術動向	120,000
5	三建資訊有限公司	【日本專家】光阻材料・微影技術開發以及應用於防止製程不良・故障因應	168,000
6	三建資訊有限公司	【日本專家】氟素樹脂的特性、合成加工、複合材料應用案例	120,000
7	三建資訊有限公司	【日本專家】邁向 EV 趨勢的 Si・SiC・GaN 功率元件技術產品路線圖及業界展望	168,000
8	三建資訊有限公司	【日本專家】環氧樹脂的高機能化技術耐熱性等各種機能之設計應用	120,000
9	三建資訊有限公司	【日本專家】RDL 重佈線技術・如何因應 3D 異質整合的 Chiplet 時代	168,000
10	三建資訊有限公司	【日本專家】精密塗佈的脫氣脫泡・攪拌混合	120,000
11	三建資訊有限公司	【日本專家】實務導向的黏著技術實際黏著力提升方法與理論	120,000
12	工業技術研究院	AI 機器學習 Machine Learning 與深度學習 DeepLearning 精修班	160,000
13	工業技術研究院	製造自動化與機器人實務培訓班	100,000
14	工業技術研究院	靜電放電 (ESD) 防護設計與測試驗證培訓班	100,000
15	工業技術研究院	六標準差 GB 綠帶實務班(含 Minitab 及 R 軟體實作)	100,000

<sup>1</sup> 政府經費以每班 20 人估計，實際執行金額依符合結訓認列學員人數撥付。

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 <sup>1</sup> (元)
16	工業技術研究院	封裝與電路板層級之訊號完整性 (SI) 分析與實務	90,000
17	工業技術研究院	啟動 AI ~ 物聯網系統規劃、建置與應用實作培訓班	100,000
18	工業技術研究院	運用 Minitab 活用 DOE 田口實驗設計方法找出最佳參數	100,000
19	工業技術研究院	智慧製造-夾治具設計與自動化應用實務培訓班	100,000
20	工業技術研究院	產品開發設計與可靠度設計 (FMEA) 技術	100,000
21	工業技術研究院	MSA-GR&R 品質測量系統分析實務應用	100,000
22	中華大學學校財團法人中華大學	RV32I RISC-V CPU 設計與 Verilog 實作	100,000
23	中華行動數位科技有限公司	物聯網應用設計	240,000
24	中華行動數位科技有限公司	AI 物件偵測暨辨識整合應用	240,000
25	中華行動數位科技有限公司	ROS 無人載具車系統開發	200,000
26	中華電信股份有限公司	5G 企業專網技術與應用訓練班	60,000
27	中華電信股份有限公司	AR 應用開發在職訓練班	200,000
28	中華電信股份有限公司	自主移動機器人 ROS 實戰班	120,000
29	台大嚴慶齡工業研究中心(公開班)	訊號及電源完整性實務	120,000
30	台大嚴慶齡工業研究中心(公開班)	系統整合之電磁相容設計實務	120,000
31	台大嚴慶齡工業研究中心(公開班)	5G 毫米波收發系統與電路設計實務	100,000
32	台大嚴慶齡工業研究中心(公開班)	5G 與次世代天線設計與驗測實務	100,000
33	台大嚴慶齡工業研究中心(企業包班)	嵌入式系統通訊基礎	83,520
34	台大嚴慶齡工業研究中心(企業包班)	Python 圖形界面程式設計	48,720

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 <sup>1</sup> (元)
35	台大嚴慶齡工業研究中心(企業包班)	Linux 驅動程式設計	83,520
36	台北科技大學	物聯網應用設計	160,000
37	台灣區照明燈具輸出業同業公會	LED 照明與光環境設計實作班(4.13 版)	100,000
38	台灣區照明燈具輸出業同業公會	利基型 LED 應用趨勢與展望	80,000
39	台灣區照明燈具輸出業同業公會	LED 智慧控制工程與應用人才培訓班	80,000
40	台灣區照明燈具輸出業同業公會	LED(二次)光學元件設計與效能模擬實務班	80,000
41	台灣區電機電子工業同業公會	5G 天線設計與射頻電路研發應用實務	100,000
42	台灣區電機電子工業同業公會	AI 邊緣運算技術趨勢與專利剖析	100,000
43	台灣區電機電子工業同業公會	5G 車聯網通訊技術與設計探究	100,000
44	台灣區電機電子工業同業公會	儲能系統與智慧電網技術應用	100,000
45	台灣區電機電子工業同業公會	電子散熱技術開發與設計實務	100,000
46	台灣區電機電子工業同業公會	鋰電池特性最佳化及熱管理模擬實務	100,000
47	台灣區電機電子工業同業公會	實現安全智慧工廠-智慧機器人與功能性標準驗證	100,000
48	台灣區電機電子工業同業公會	數位分身-自動化產線模擬與機械手臂離線編程規劃	100,000
49	台灣區電機電子工業同業公會	人工智慧與機器學習應用實務	100,000
50	台灣區電機電子工業同業公會	高速傳輸介面最新技術演進與設計挑戰	100,000
51	台灣電路板協會	PCB 微切片實務與案列分享	100,000
52	台灣電路板協會	R 軟體於機器學習之應用	100,000
53	台灣電路板協會	車用電子可靠度驗證與測試	100,000

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 <sup>1</sup> (元)
54	平坦化應用協會	CMP 製程技術課程	100,000
55	平坦化應用協會	CMP 材料技術課程	100,000
56	自強工業科學基金會	VLSI 積體電路 ESD 防護佈局設計與佈局專利分析	80,000
57	自強工業科學基金會	低電壓低功率類比數位與數位類比轉換器設計	80,000
58	自強工業科學基金會	奈米級 MOS 電晶體	70,000
59	自強工業科學基金會	功率半導體工程及組件特性介紹	80,000
60	自強工業科學基金會	積體電路製程流程與故障分析技術	70,000
61	自強工業科學基金會	電源管理晶片設計	120,000
62	自強工業科學基金會	半導體元件(含 AEC 車規)可靠度測試實務	70,000
63	自強工業科學基金會	AOI 自動光學檢測(實作)	70,000
64	自強工業科學基金會	14 小時快速掌握 Python 專案開發(實作)	70,000
65	自強工業科學基金會	OpenCV 影像處理與電腦視覺(實作)	70,000
66	自強工業科學基金會	人工智慧與深度學習 (實作)	70,000
67	自強工業科學基金會	深度學習模型與影像辨識應用	70,000
68	自強工業科學基金會	Python 與機器學習實務(實作)	70,000
69	艾錡科技有限公司	AI 於物聯網之應用 (使用 Tensorflow.js)	120,000
70	車輛研究測試中心	先進車輛智慧感知與控制決策系統開發與應用技術	100,000
71	車輛研究測試中心	電動車馬達驅動控制與系統整合技術	100,000
72	車輛研究測試中心	車電 EMC 設計與對策實務及完整案例分析	100,000

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 <sup>1</sup> (元)
73	車輛研究測試中心	電動車用電池包與電池管理系統安全設計	100,000
74	車輛研究測試中心	OBD-II 車上診斷系統原理、應用與系統開發實務	100,000
75	亞卓國際顧問股份有限公司	六標準差綠帶培訓(台南班)	280,000
76	亞卓國際顧問股份有限公司	專利強化再生與迴避(台南班)	140,000
77	亞卓國際顧問股份有限公司	新版 IATF16949:基礎知識與五大核心工具實務應用訓練(台南班)	224,000
78	拓璞科技股份有限公司	智慧工廠建置規劃與方案	100,000
79	拓璞科技股份有限公司	穿戴裝置的血液量測功能與實務設計	100,000
80	社團法人台灣電子設備協會	3D IC 與 FOPLP/FOWLP 封裝製程與設備技術人才培訓班	100,000
81	社團法人台灣電子設備協會	Mini/Micro LED 技術與製程設備的開發人才培訓班	100,000
82	社團法人台灣電子設備協會	半導體元件與製程技術人才培訓班	100,000
83	社團法人台灣電子設備協會	5G 通訊化合物半導體 (GaN) 應用技術人才培訓班	100,000
84	社團法人台灣電子設備協會	第三代半導體功率元件關鍵技術與應用商機人才培訓班	100,000
85	社團法人台灣電子設備協會	半導體製造與故障分析技術人才培訓班	100,000
86	社團法人台灣電子設備協會	5G 時代的化合物半導體材料及應用人才培訓班	100,000
87	社團法人台灣電子設備協會	高精密雷射精微加工技術與半導體產業應用人才培訓班	100,000
88	社團法人台灣電子設備協會	先進封裝 RDL 重佈線技術人才培訓班	100,000
89	財團法人光電科技工業協進會	矽光子超快光通訊技術研討會技術人才培訓班	100,000
90	國立高雄大學	軟體生命週期管理	72,000
91	國立高雄大學	機台通訊軟體開發	72,000

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 <sup>1</sup> (元)
92	國立高雄大學	自動控制應用	72,000
93	國立陽明交通大學	射頻通訊系統分析與設計	100,000
94	國立陽明交通大學	超取樣資料轉換器設計含實作	100,000
95	國立陽明交通大學	下世代無線通訊之軟體定義射頻接收機設計	100,000
96	國立陽明交通大學	SRAM Design in Nanoscale CMOS	100,000
97	國立陽明交通大學	低靜態電流線性穩壓器設計與切換式電源管理晶片	100,000
98	新矽國際顧問股份有限公司	Linux 核心驅動程式開發(N)	48,000
99	新矽國際顧問股份有限公司	Android HAL 與 Framework 開發	48,000
100	新矽國際顧問股份有限公司	ESD & Latch Up Design	48,000
101	新矽國際顧問股份有限公司	影像物件偵測演算觀念與開發實務	48,000
102	新矽國際顧問股份有限公司	深度學習重要觀念與影像辨識開發實務	48,000
103	新矽國際顧問股份有限公司	Linux 核心驅動程式開發(S)	48,000
104	新矽國際顧問股份有限公司	色域轉換技術	48,000
105	新矽國際顧問股份有限公司	密碼原理與應用	48,000
106	新矽國際顧問股份有限公司	高速 SerDes Adaptive EQ/ GHz PLL circuit design	48,000
107	雷蒙德管理顧問有限公司	氮化鎵單晶微波積體電路設計	100,000
108	雷蒙德管理顧問有限公司	5G 射頻與毫米波前端積體電路設計	100,000
109	雷蒙德管理顧問有限公司	GaN 製程技術開發	100,000
110	雷蒙德管理顧問有限公司	GaN 高頻及高功率元件應用	100,000
111	雷蒙德管理顧問有限公司	GaN 磊晶技術	100,000
112	雷蒙德管理顧問有限公司	人工智慧簡介與積體電路實現	100,000
113	雷蒙德管理顧問有限公司	QIT / 新 QC 七大手法	100,000

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費 <sup>1</sup> (元)
114	雷蒙德管理顧問有限公司	高科技經理人創新管理養成班	120,000

◎備取班級<sup>2</sup>

序號	開班單位(依筆劃排序)	課程名稱	政府經費(元)
1	工業技術研究院	矽智財設計與驗證分析	100,000
2	工業技術研究院	產線電磁干擾(EMI) 防制設計與接地工程培訓班	100,000
3	工業技術研究院	電子電路介紹與 EDA 模擬分析驗證實作培訓班	100,000
4	工業技術研究院	次微米級設備設計實務	100,000
5	國立交通大學	3D IC 應用與製程簡介	100,000
6	自強工業科學基金會	無線射頻前端口系統設計實務	70,000
7	自強工業科學基金會	無線通訊基頻電路設計	70,000
8	自強工業科學基金會	高階 CIS(CMOS Image Sensors)原理及未來發展 與應用	80,000
9	亞卓國際顧問股份有限公司	TRIZ 系統化創新方法班	72,000
10	拓璞科技股份有限公司	AI 於自駕車環境偵測之技術與實證	100,000
11	社團法人台灣電子設備協會	智慧醫療影像處理與分析實務人才培訓班	100,000

<sup>2</sup> 備取班級將視整體開班狀況及經費運用情形，由計畫辦公室另行通知開班單位遞補開班及招生。